

Prensa Quente Automática De Laboratório Para Ultra-Alta Temperatura 10 Toneladas 400°C 300X300Mm

Número do item: XP91



introdução

Conheça a prensa quente automática de laboratório de 10 toneladas com temperatura ultra-alta de 400°C e placas de 300x300mm. Ideal para processamento avançado de polímeros, oferece pressão programável e controle de temperatura PID de placa dupla para resultados precisos. Explore nossa linha completa.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Produção de Filme de Poliimida (PI)	Produção de filmes finos resistentes a altas temperaturas para eletrônicos flexíveis e isolamento.	Alcança espessura uniforme e propriedades dielétricas superiores por meio de controle preciso de temperatura/pressão.
Moldagem de Compósitos de PEEK	Moldagem por compressão de PEEK preenchido com fibra de carbono para implantes aeroespaciais e médicos.	Garante total impregnação das fibras e laminados sem vazios e de alta resistência.
Estampagem a Quente de Termoplásticos	Replicação de padrões em substratos poliméricos para chips microfluídicos e MEMS.	Oferece transferência de recursos de alta fidelidade graças a placas planas e paralelas e rampas de força programáveis.
Laminação de Eletrodos de Bateria	Laminação de folhas de eletrodos para células de íons de lítio sob calor e pressão controlados.	Melhora a adesão do material ativo e a uniformidade do eletrodo, fundamental para o desempenho da célula.
Preparação de Amostras de Polímero	Moldagem por compressão de placas de teste de acordo com normas ASTM/ISO.	Produz corpos de prova dimensionalmente precisos e reproduzíveis com mínima variabilidade do operador.
Fundição de Filme Fino para Análise	Fundição de grânulos termoplásticos em filmes finos para análise por FTIR ou XRF.	Gera filmes limpos e sem bolhas de forma rápida e consistente.
Laminação de Filme Multicamadas	Colagem de várias camadas de polímero sob calor e pressão para embalagens de barreira.	Alcança forte adesão entre camadas sem retenção de ar ou descolamento.
Encapsulamento Fotovoltaico	Laminação de encapsulantes de células solares como EVA ou POE.	Garante espessura uniforme e encapsulamento sem bolhas, prolongando a vida útil do módulo.

Parâmetro	Especificação
Modelo	XP91
Pressão Máxima	10 Toneladas (100 kN)
Controle de Pressão	Programável, pressurização, retenção e liberação automáticas de vários estágios
Temperatura de Trabalho	Temperatura ambiente até 400°C
Controle de Aquecimento	PID independente de placa dupla com rampa/aquecimento/resfriamento programáveis
Potência de Aquecimento	3500 W
Tamanho da Placa	300 × 300 mm
Abertura de Luz	60 mm
Método de Resfriamento	Resfriamento por circulação de água; chiller dedicado opcional disponível

Parâmetro	Especificação
Fonte de Alimentação	AC 220-240 V, 50/60 Hz monofásico (padrão 60 Hz para EUA)
Dimensões (C×L×A)	400 × 490 × 580 mm
Peso Líquido	280 kg